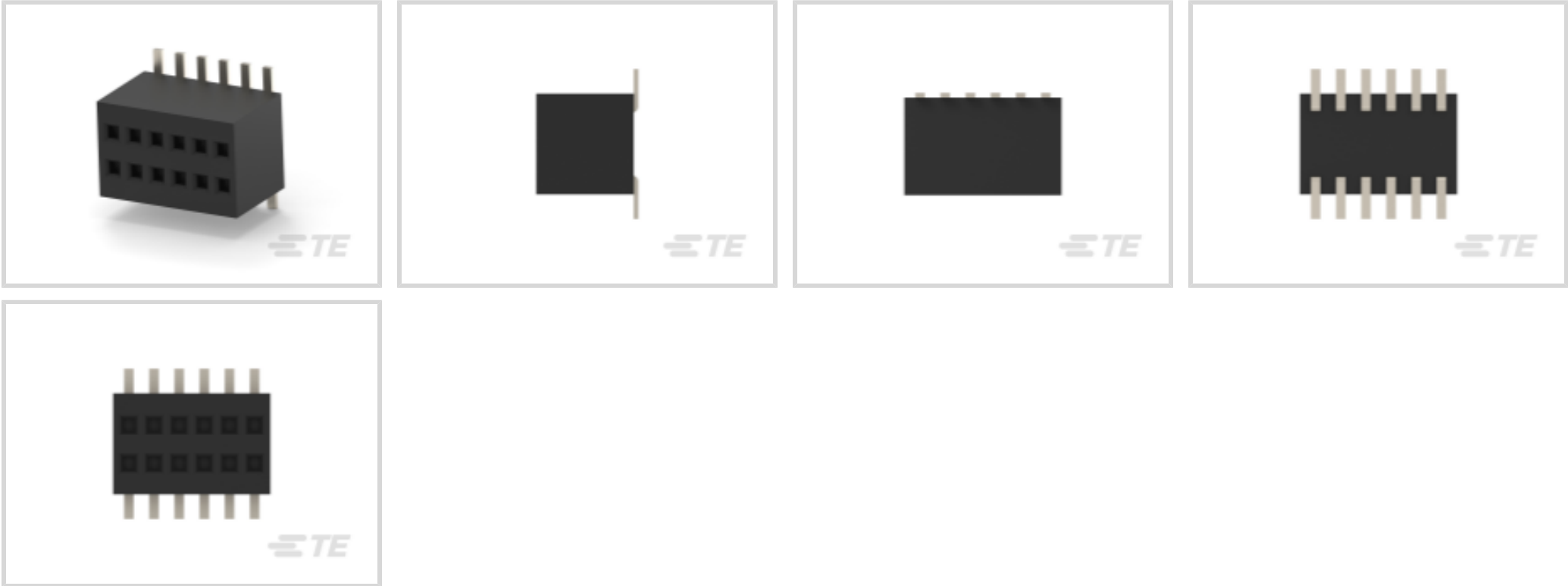




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: .8 mm [.03 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	12
板对板配置	平行

接触件特性

端子底板材料	铜
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	黄铜
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	.75 A



端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.75 mm
矩形端接柱体和尾部宽度	.3 mm[.012 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.03 in]
外壳材料	Zamak 5, Zamak 5

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

注释	管
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2271988-2
MODU0.8,PIN,12P,DRRA,SMT,10AU

客户还购买了

TE 产品编号1393788-3
V23079A1001B301

TE 产品编号1825027-8
FSMRA3JH04=R/A,TACT PB SW,160G

TE 产品编号1-2271988-2
MODU0.8,PIN,12P,DRRA,SMT,10AU

文档

产品图纸

MODU0.8,REC,12P,DRST,SMT,10AU,H=3.1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2271989-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2271989-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2271989-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本